

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

BUSINESS
REPORT
2010



フジミインコーポレーテッドは、1950年の創業以来、分級技術などを活かした精密人造研磨材メーカーとして独自の歩みを続けてきました。蓄積されたノウハウと研究開発から生まれた製品の数々は、光学レンズ用研磨材から出発し、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっています。その他、太陽電池パネル切断や、水晶デバイス研磨用にも使われています。最近では、耐衝撃性を飛躍的に高めたサーメット溶射材の商品化で新分野を開拓しています。

Profile

Since its founding in 1950, Fujimi Incorporated has continued to chart a course as a manufacturer of synthetic precision abrasives. Drawing on its accumulated expertise and extensive research and development (R&D) capabilities, the Company has expanded from abrasives for optical lenses to a variety of products that deliver the ultraprecise planarization sought by leading-edge high-tech industries.

Fujimi's lineup covers the complete spectrum from compounds for silicon wafers and other semiconductor substrates, to chemical mechanical planarization (CMP) products required for multilayered circuits on semiconductor chips, compounds for computer hard disks, and abrasives for slicing wafers for solar cells and quartz devices. Recently, the Company is cultivating new fields, commercializing products for cermet (ceramic-metallic composite) thermal spray materials with dramatically improved impact resistance.

Contents

社長あいさつ	1	Message from the President
当社の経営方針	2	Management Objectives
研究開発活動	6	Research and Development Activities
財務レビュー	8	Financial Review
経営指標（連結）	9	Selected Financial Data (Consolidated)
連結損益計算書	13	Consolidated Statements of Income
連結貸借対照表	14	Consolidated Balance Sheets
連結キャッシュ・フロー計算書	16	Consolidated Statements of Cash Flows
株式情報	17	Stock Information

皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

各国政府の財政・金融政策協調や新興国での経済の回復などにより牽引された世界経済は、回復に向けた動きを示しつつあります。しかしながら、米国での金融問題は終結したとは言えず、新たに浮上した欧州における財政問題や、再び上昇傾向にある原油価格などがあいまって、世界情勢は引き続き不透明であり経済の回復も確かなものとは言いがたい状況にあります。

当社第58期はお客様の在庫調整が一巡したこととデジタル家電製品需要の回復などにより、当社業績は最悪期を脱し回復基調を示しました。当社の主力である半導体シリコンウェハー向け製品については、ラッピング材の売上高が3,198百万円（前期比16.8%減）、ポリシング材の売上高は7,839百万円（前期比17.0%減）となりました。半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるCMP（化学的機械的平坦化）向け製品につきましても、半導体の需要回復の動きはあったものの、売上高は7,262百万円（前期比12.1%減）となりました。以上の結果、2010年3月期の業績は、連結売上高28,177百万円（前期比17.4%減）となりました。こうした中、当社グループは一丸となってコスト削減に努め、営業利益1,496百万円（前期比3.3%減）、経常利益1,699百万円（前期比3.3%増）、純利益1,161百万円（前期比93.5%増）となりました。

当社は最終年度を2018年3月期とする、新中長期9ヵ年経営計画を昨年よりスタートいたしました。9年を3年ごとの中期計画に分け、最初の3ヵ年は自己診断と成長のための基礎体力づくり、成長のための種まきに充てます。次の3ヵ年はまいた種をきちんと育てる時期、そして最後の3ヵ年は事業が花開き、実をもたらす時期、と位置づけています。

中長期計画では既存事業の強化に加えて、新規用途の拡大や新規事業育成も盛り込みました。また、あわせて企業理念や事業ビジョンについても見直しを行いました。さらに、企業理念や事業ビジョンの達成のために、土台となる企業風土の改革にも挑戦しております。社員一人ひとりが新しいことに積極果敢に挑戦していく、そんな風土の醸成が当社の持続的成長に必須であると考えています。

中長期経営計画2年目の今年は、当社のさらなる成長のための体制が着実にできつつあることが実感できる年にしたいと考えております。当社の目標でもある『強く、やさしく、面白い』会社の実現を目指して変革の動きが根付き、より確かな動きとすることで、中長期計画の第一段階である成長への基礎固め・体制づくりの完了につなげていきたいと思っております。

皆様のご厚情に感謝いたしますとともに、これまでと変わらぬご支援をいただきますようお願い申し上げます。

2010年7月
代表取締役社長

関 敬史

During the year, the worldwide economy began to show signs of recovery as a result of the coordinated economic and monetary policy initiatives by several countries to stimulate the economy. However, the U.S. financial crisis that triggered the recession has not ended and also new financial issues have arisen in Europe along with resurgent crude oil prices. As a result of this situation, the business outlook remains unclear, and economic recovery is by no means certain.

In the fiscal year ended March 31, 2010, corresponding to Fujimi's 58th year of operations, Fujimi recovered from the worst period of its business performance, due to many of our customers dealt with their inventory adjustments. In addition, demand for consumer electronics rebounded, seeming to suggest that the worst was over in terms of Fujimi's business performance. In the Company's mainstay business, products for semiconductor silicon wafers, sales of lapping materials decreased 16.8% compared with the preceding year, to ¥3,198 million, and sales of polishing compounds dropped 17.0%, to ¥7,839 million. Our products for chemical mechanical planarization (CMP), a process used in the multilayering technologies that are employed to achieve higher semiconductor component populations and increasing levels of miniaturization, benefited from a recovery in semiconductor demand. Nevertheless, sales fell 12.1%, to ¥7,262 million. On a consolidated basis for the year ended March 31, 2010, Fujimi posted net sales of ¥28,177 million, down 17.4% year on year. Owing to full-fledged companywide efforts to reduce costs, we achieved operating income of ¥1,496 million, down 3.3%. Ordinary income increased 3.3%, to ¥1,699 million, and net income surged 93.5%, to ¥1,161 million.

We have put in place a new Mid-Long Term Management Plan, which concludes in the fiscal year ending March 31, 2018. This nine-year plan is divided into three successive three-year plans, the first of which involves self-analysis and establishing the foundations for growth—"seeding" our operations. The second stage involves raising the planted seeds, and at the third stage we plan to reap the results of the seeds of progress we have planted.

In addition to strengthening existing businesses, the plan calls for us to expand new applications and develop new businesses. We also reviewed our corporate philosophy and corporate vision. We are striving to transform our fundamental corporate culture to put our corporate philosophy and vision into practice. To achieve ongoing growth, it will be necessary for each employee to take a proactive approach toward new challenges.

Now moving into the second year of our Mid-Long Term Management Plan, we plan to make steady progress toward the objectives we have outlined. As we work toward our goal of being a "strong, kind and exciting company," we will strive to put in place the foundations for growth and the structures called for in the first stage of our Plan.

In these and all our efforts, we ask for your continued support and understanding.

Keishi Seki, President
July 2010



■ 当社の経営方針

はじめに

世界経済は緩やかな回復に向かっています。当社の中核事業である半導体産業においては、在庫調整が一段落したものの新たな設備投資などには依然として慎重な動きが続いており、いまだ確かな回復の足取りは見えていません。日本企業の多くは、経済動向をにらみつつ、足元の生産体制をいかにして再構築していくのかの決断を迫られています。

そのような環境の下、当社は「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の高品質化と安定供給に努めております。

フジミの企業理念

企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢

- 経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- 技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

行動規範

- 夢の実現に向け、熱意、誠意、創意をもってチャレンジします。
- 問題の本質を追求し、迅速かつ確実に解決します。
- 良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。
- ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力、は変わることがありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術水準の高度化に対して、迅速かつ的確に対応し、「顧客満足を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

企業ビジョン

企業ビジョンは、「事業アイデンティティ」「企業文化ビジョン」「事業構造ビジョン」の3つから構成されています。

「事業アイデンティティ」

表面加工分野で世界最高技術を提供し、私たちが理想と考える「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが考える「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。

- ・ 企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、活き活きと仕事に取り組む。
- ・ 循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

「企業文化ビジョン」

強く、やさしく、面白い会社を目指します。

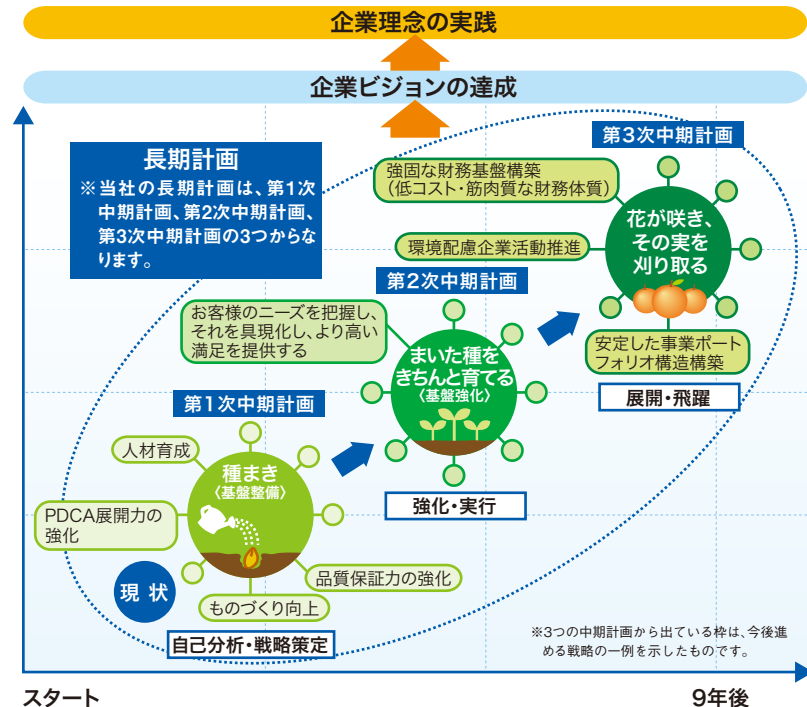
- ・ 自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。（強く）
- ・ 仲間を大切にし、助け合い、感謝します。（やさしく）
- ・ 夢をいただき、夢がかなう職場をつくります。（面白い）

「事業構造ビジョン」

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野（シリコン・CMP）と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

中長期的な会社の経営戦略

当社はバランス・スコアカード（BSC）の考え方を基に、2009年6月に2018年3月期を最終年度とする中長期経営計画を策定いたしました。この中長期経営計画は、3年を区切りとする3次の中期計画を基にして、数値的な定量的な計画だけでなく当社のあり



Introduction

The global economy is gradually recovering. In the semiconductor industry, the Company's mainstay customer segment, inventory adjustments have subsided to a certain degree, but manufacturers continue to take a cautious approach toward new capital investment. Consequently, the outlook for recovery in our business remains uncertain. Furthermore, many Japanese companies are keeping a watchful eye on economic trends as they decide whether to take further measures to restructure their existing production systems.

Under such circumstances the Company has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered on its base in powder technologies. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management

Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality products, a manufacturing approach from which we have never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain the same.

Corporate Philosophy

Corporate Mission

To develop new technologies to meet the needs of high-tech industries, and contribute to the creation of a bright future that is friendly to the earth.

Management Policy

- To correspond to changes in the business environment, we continue to take on new challenges and make reforms positively.
- We propose original solutions by adopting the viewpoint of the customer.
- We respond to the trust our stakeholders placed in us by improving the quality of our technology and management, and observing the law.

Code of Conduct

- We accept challenge with enthusiasm, honesty and creativity, as we work to achieve our goals.
- We search for the essence of problems and solve them with quickly and with certainty.
- We will act as a good corporate citizen and maintain a strong sense of ethics.
- We respect and act on individual ideas.

Corporate Vision

Our corporate vision comprises our Business Identity, Corporate Cultural Vision and Business Structure Vision.

Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the surface processing field, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

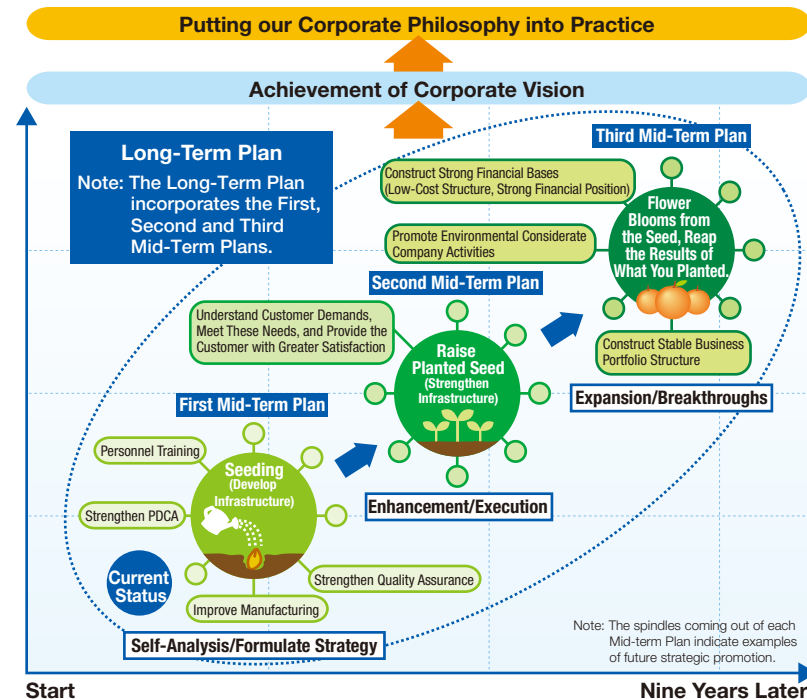
- (1) Respond to change precisely, and grow continuously.

- (2) Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- (3) Contribute to decreasing the environmental impact as a member of a recycling-based society.

Corporate Cultural Vision

Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)



たい姿を含めた定性的な計画としています。

中期計画の第一段階は自己診断と成長のための基礎体力づくり、成長のための種まきにあて、第二段階はまいた種をきちんと育てる時期、そして第三段階は事業開花させ、実を収穫する時期、とそれぞれ位置づけています。

中長期計画の2年目にあたる今期は、第1次中期計画の「種まき〈基盤整備〉」の時期に相当し、「人材育成」「ものづくり向上」「品質保証力の強化」に力を傾注しています。種をまくには、畑の土づくりも大切な課題であり、企業の風土改革にも全力で取り組んでいます。

各事業の取り組み

今後当社は、経済環境の変化が見込まれるなかでアグレッシブな成長を目指し、積極果敢にチャレンジしなければならないと考えております。それに加えてどの様な景気変動下にあっても安定的な成長を遂げるため、特定の事業や用途に偏ることがない事業構造が必要と考えております。そのため従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・溶射材・機能性材の5事業に加え、新規事業と新たな用途の探索に継続的にチャレンジし、その実現に向け様々な可能性を含めた検討を進めることとしました。具体的には技術本部に基盤技術課を設立し、(1) ろ過・分級、(2) 砥粒、(3) ケミカル

の3つのコア技術を中心に、技術開発を進め、商品開発の加速、事業のさらなる拡大を推進しております。このことを通じて安定した事業構造を維持するため、将来的には事業構造比率として半導体関連比率50%、非半導体関連比率50%を目指しております。

また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策として具現化し、その成果については戦略テーマ評価指標 (KPI) によって四半期ごとに進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦略を組織横断的に展開しております。

シリコン事業

半導体の基板であるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面研磨する研磨材事業です。お客様へのタイムリーな新製品の供給とトータルコストメリットの提言を目指し、モノづくりの意識を高めコア技術の確立と発展に注力し、高い世界シェア維持を目指してまいります。

CMP 事業

半導体チップの高集積化を多層配線で実現する CMP は今後も拡大が期待されます。お客様のロードマップに合った迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、より密接なお客様との関係構築や開発力の強化を目指してまいります。収益性の面では、安定品質の提供に努め、開発経費効率化や製造原価率の低減を図ってまいります。

ディスク事業

パソコンやHDD 搭載型 DVD レコーダーなどに搭載される記憶媒体であるハードディスク基板研磨用の研磨材事業です。各業界のニーズをいち早くキャッチし、開発期間の短縮化によりお客様の要求に合った開発品をタイムリーに提供してまいります。また、生産技術力を高め、低コスト化に向けた製造プロセスの改善を図り、生産コストの削減により利益率の向上につなげてまいります。

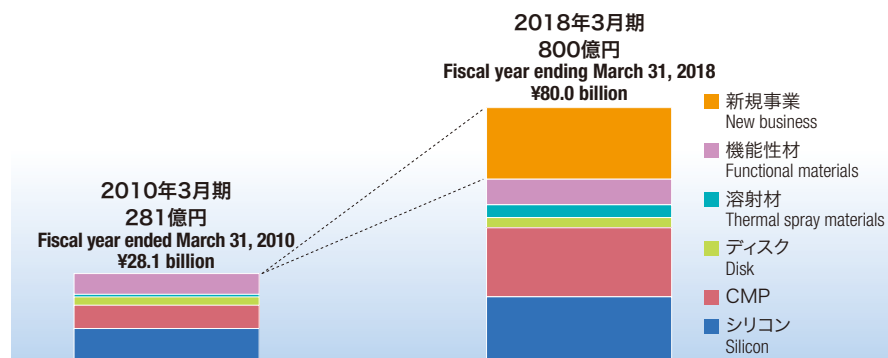
溶射材事業

溶射業界向けにサーメット溶射材とセラミックス溶射材を提供しております。開発力を強化し、新規高機能品の早期上市やタイムリーなソリューションの提案により、売上的大幅拡大を目指してまいります。また、収率のアップや生産技術の向上でコストダウンを図ってまいります。

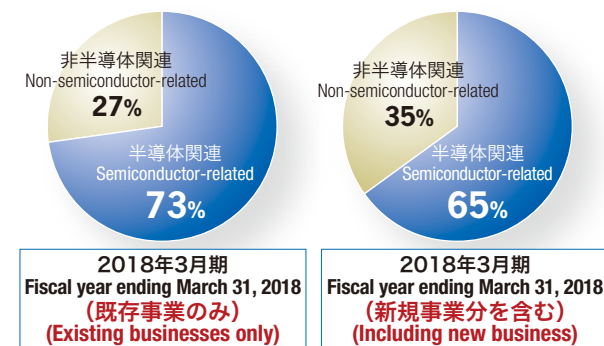
機能性材事業

光学レンズ研磨用新製品の開発に注力し、高能率で低面粗度を可能とする高性能なダイヤモンドペレットを市場に投入し、売上の拡大につなげてまいります。また、精密砥石関係、研磨布紙関係、一般ラップ関係、その他製品に対しては、品質の維持向上や納期の迅速化、用途の新たな提案等でお客様の信頼を高めるとともにコストの抑制に取り組み、利益の向上を図ってまいります。

中長期経営計画経営目標
Management Targets of the Mid-Long Term Management Plan



事業構造ビジョン (売上構成比)
Business Structure Vision (Composition of Sales)



Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

Mid-Long Term Management Strategy

Based on its core concept of a Balanced Scorecard (BSC), Fujimi has formulated a Mid-Long Term Management Plan to guide the Company from June 2009 through the fiscal year ending March 31, 2018. The plan is separated into three parts and is based on three successive mid-term plans. In addition to quantifiable objectives, the plan includes qualitative elements that describe the type of organization Fujimi aims to become.

The first stage of our mid-term plan involves self-analysis and establishing the foundations for growth—“seeding” our operations. The second stage involves raising the planted seeds, and at the third stage we plan to reap the results of the seeds of progress we have planted.

Now moving into the second year of the first stage, we are in the “seeding” phase, and accordingly we are pursuing initiatives involving personnel training, improving manufacturing and strengthening quality assurance. Recognizing that seeding is the stage that is most important to future success, we are putting every effort into

initiatives that will eventually transform the Company.

Initiatives by Department

Fujimi understands that achieving its aggressive growth targets in a changing economic environment will require it to take a proactive stance toward upcoming challenges. Furthermore, ensuring stable growth under fluctuating business conditions requires the Company to adjust its business structure along the lines of specific businesses and applications. For this reason, we will continue our search for new businesses and applications in addition to the five areas we have pursued to date (Silicon, CMP, Disk, Thermal spray materials and Functional materials). We have established a specialized section in our R&D Division, concentrating mainly on three core technologies involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, for promoting technological development, accelerating product development and targeting further business expansion in these areas. Through these efforts, we aim to achieve a business structure in which 50% of our revenues come from silicon-related businesses and 50% from non-silicon businesses.

On a companywide level, we have established strategic targets for the five businesses, by creating specific measures and defining key performance indicators to monitor progress on a quarterly basis. We are deploying operational strategies across

the organization, based on a system of clearly defined responsibilities.

Silicon Business

Silicon business involves providing the abrasives to deliver highly precise planarity and smoothness on the silicon wafers used as semiconductor substrates. In this category, we are working to enhance the level of our core technologies and apply our understanding of manufacturing, as well as aiming to maintain high market share, by providing useful new products to customers in a timely manner and proposing overall cost benefits.

CMP Business

Demand for chemical mechanical planarization (CMP) products is expected to expand to achieve multilayer wiring as the number of components populating semiconductor chips increases. In this category, we aim to forge closer relationships with our customers and enhance our development capabilities by swiftly providing newly developed products and technical services to customers that match their development roadmaps. To raise profitability, we will endeavor to stabilize product quality, raise R&D cost efficiency and lower cost of sales.

Disk Business

Our compounds are used in the manufacture of the hard disk substrates found in personal computers and DVD recorders with onboard HDDs. To precisely meet

demands in different industries, we are working to shorten development lead times so that we can meet customer demands in a timely and appropriate manner. Accordingly, we are focusing on enhancing production technologies and improving production processes. These efforts should reduce production costs and lead to higher profitability.

Thermal Spray Materials Business

Fujimi provides cermet and ceramic thermal spray materials to customers in the thermal spraying industry. By quickly bringing to the market products with new functionality and proposing timely solutions, we intend to raise sales from these operations significantly. We are also targeting higher levels of profitability and cost reductions through the application of more advanced production technologies.

Functional Materials Business

In this category, Fujimi’s abrasive compounds used to polish optical lenses employ high-performance diamond pellets, which leave little residue on the polished surface, and sales of these products are increasing. For precision grindstones, polishing cloths, general lapping materials and other products, we are working to shorten delivery lead times while maintaining or increasing quality levels, and also to propose new applications. We expect to enhance our trust-based customer relationships, curtail costs and raise profits.

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に積極的に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコアとなる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査企画機能の強化に努めています。

シリコンウェハー

300mm ウェハーの需要拡大、デザインルールの超微細化に伴い、超精密研

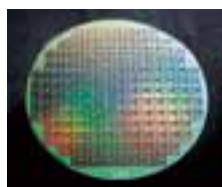


磨の要件である、①平坦化、②無欠陥化、③平滑化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっています。平坦化と生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工精度と加工歩留まり向上のために、砥粒の細粒化に注力しています。

最終仕上げに用いられるポリシング材では、無欠陥化、平滑化、汚染低減への要求がますます強くなっています。22nm デバイス世代のウェハー研磨用として、研磨後表面のナノ欠陥を激減させるポリシング材や、原子レベルの平滑性を実現するポリシング材の開発を推進しています。また、研磨後の汚染残留を低減すべく、材料の高純度化や汚染付着を低減する機能を持つ、添加剤技術の開発にも取り組んでいます。

デバイス CMP

デバイスメーカー各社では、配線材料として銅 (Cu) の採用が拡大しています。45nm デバイス



の量産が広がる中、32nm デバイスの量産が開始され、さらには22nm 向けのプロセス開発も進んでいます。当社では、多層配線化で市場が急拡大している Cu、バリア材用のポリシング材を中心に、お客様の最先端の要求を満たす新商品の開発を進めています。これらの用途では、配線表面のナノオーダーの平坦化、無欠陥化、平滑化が強く求められており、砥粒、ろ過・分級、ケミカル技術の活用により、これらの性能の向上に取り組んでいます。また、poly-Si (ポリシリコン)、ILD (層間絶縁膜)、W (タングステン) 用のポリシング材に対しても、新規デバイス構造への対応も含めまして、お客様の要求に応じた性能向上に努めています。300mm ウェハーや最先端の微細化に応じた、研磨機・表面検査装置を揃え、お客様と協力して、新商品の開発に取り組んでいます。

ハードディスク

次世代の大容量・高密度ハードディスクに対応した高性能ポリシング材の開発に注力して



います。欠陥・汚染低減への要求はハードディスク基板においても半導体同様になっ

てきており、これに応えるべく、新商品の開発を推進しています。

溶射材

電子デバイス・液晶製造装置用高純度セラミックスや鉄鋼分野の各種製



造装置用サーメットなどの高付加価値皮膜用溶射材等の用途開発による適用範囲の広がりから、市場規模の拡大が見込まれます。研究開発としては、近年、進展が著しい低温溶射法 (コールドスプレー、ウォームスプレー) 等の新規溶射法に適した溶射材の開発などに重きを置いて推進しています。

基盤技術

基盤技術部門では当社のコア技術のさらなる強化に努めております。①ろ過・分級、②砥粒、③ケミカルの3つのコア技術を中心に技術開発を進め、商品開発の加速、高性能化、新規事業分野への展開に貢献してまいります。

新規分野

半導体 / 非半導体のバランスのとれた商品群構築を目指し、急速な市場拡大が見込まれる環境・エネルギー分野を中心に、新規商品の企画・開発を推進しています。急成長している LED 用サファイア基板や、次世代パワーデバイス用として期待されている GaN・SiC 基板など、従来技術では加工が難しい、硬脆材料の研磨・研削材の開発

を推進しています。

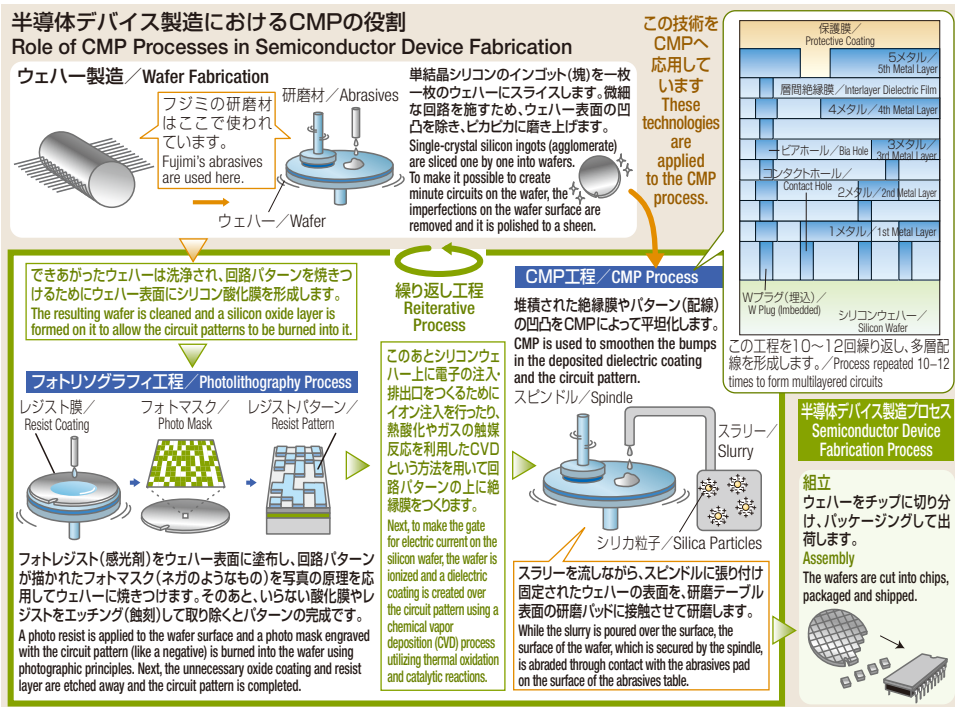
また、炭化ケイ素やアルミナなど、原材料の特徴を生かした機能性材料、光学用レンズの研削材の開発にも取り組んでいます。

開発企画部門においては、当社コア技術が展開可能な分野を、技術と市場の両視点から探索し、新規商品・新規開発テーマの企画を推進しています。

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its aggressive development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is core to our growth. We are working to strengthen our technology-based new business and topics research and planning function.

Silicon Wafer Compounds

In accordance with the increased demand for 300mm wafers and shrinking design rules, demand is increasing for synthetic precision abrasives that are (1) flat, (2) free from defects and (3) smooth, and that (4) minimize contamination from trace metals and (5) improve manufacturing. We are focused on abrasive grain refinement to improve the processing accuracy and yield rate for lapping and silicon wafer slicing abrasives, which are also required for



high-performance flatness and improved manufacturing.

The demand for flat, defect-free, smooth and uncontaminated polishing compounds used in the finishing process are growing stronger. We are developing polishing compounds that will reduce nano defects and achieve the level of smoothness required in polishing next-generation wafers for 22nm devices, as well as polishing compounds that achieve atomic level smoothness. Fujimi is also engaged in the development of additive technologies that possess a high level of purity and low contaminant adherence to decrease residual defects after polishing.

Device CMP

Device manufacturers are using more copper as wiring material. As the mass production volume of devices using 45nm design rules expands and those using 32nm design rules commence, we are engaging in the development of processes for 22nm devices. With the market for multilayer copper wiring expanding rapidly, we are concentrating on polishing material for copper and barrier materials as we pursue the development of products that will meet customer requirements for the manufacture of leading-edge products. We are developing materials that meet strong demand for nanometric wiring surface planarity, absence of defects, and

smoothness. To this end, we are working to deliver higher performance in the areas of abrasives, filtration and classification, and chemical technologies. We are also boosting the performance of conventional polishing compounds for polysilicon, interlayer dielectric (ILD) and tungsten, in response to customer requirements to match structures for new devices. As the use of 300mm wafers and smaller design rules become more prevalent, we are also working with customers to develop new polishers and surface testing equipment.

Compounds for Hard Disks

Fujimi is focusing on the development of high-performance polishing compounds for next-generation hard disks, which have greater storage volumes and higher densities. As with semiconductors, customers are demanding products for hard disk substrates that ensure fewer defects and leave fewer residues. We are developing products to meet these needs.

Thermal Spray Materials

The market for thermal spray materials is growing rapidly as applications for thermal spraying expand. Fujimi is focusing on thermal spray materials used to form high-value-added coatings on, among others, high-purity ceramics used in electronics and semiconductor manufacturing equipment and cermet used in the steel industry. Rapid advances in recent years in the areas of low-temperature thermal spraying (cold spraying and warm spraying) have stepped up needs for the development of materials compatible with new thermal spray methods.

Core Technologies

This section focuses on reinforcing Fujimi's strengths in core technologies. By promoting the development of technologies mainly involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, the section will accelerate product development, target greater functionality and help expand the Company's operations into new fields of business.

New Applications

Aiming to strike a balance between semiconductor and non-semiconductor operations, Fujimi is planning and developing new products centered on environmental and energy-related fields, for which markets are expected to grow rapidly. The market is expanding rapidly in the area of sapphire substrates for LEDs and gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) substrates for next-generation powered devices. Therefore, we are developing abrasion and polishing compounds that allow the polishing of highly brittle materials—a task that presented difficulties in the past. Fujimi also continues to promote the development of abrasive compounds made from SiC, alumina and other raw materials with specific functional characteristics, as well as materials used to polish optical lenses.

In planning its new product and development themes, Fujimi's R&D planning section takes a two-pronged approach to determining development targets, as it looks for fields with development potential for the Company's core technologies, as well as promising new technologies and markets.

【半導体ウェハー用】

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、当期第二四半期よりウェハー生産量が回復基調となったものの、当期第一四半期の低迷が大きく、ラッピング材の売上高は3,198百万円（前期比16.8%減）、ポリシング材の売上高は7,839百万円（前期比17.0%減）となりました。

【CMP用】

半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線プロセスに使用されるCMP(化学的機械的平坦化)向け製品につきましては、半導体デバイスの需要回復の動きはあったものの、売上高は7,262百万円（前期比12.1%減）となりました。

【ハードディスク用】

ハードディスク向け製品につきましては、ノートパソコンなどの需要増により、当期第二四半期以降ガラス基板向け製品が好調に推移したものの、当期第一四半期の低迷が大きく、売上高は2,570百万円（前期比25.9%減）となりました。

【ワイヤーソー用・溶射材・水晶デバイス用・その他】

シリコン切断に使用されるワイヤーソー向け製品につきましては、主に欧州において太陽電池市場が低調であったことから売上高は1,897百万円（前期比24.7%減）となりました。

溶射材につきましては、主力であるサーメット溶射材を中心に製品の拡販に努めましたが、鉄鋼・半導体などの業界の低迷もあり、売上高は876百万円（前期比10.1%減）となりました。

水晶振動子などの研磨に使われる水晶デバイス向け製品につきましては、市場価格下落の影響を受けたものの、携帯電話向け需要が拡大し、売上高は615百万円（前期比13.4%増）となりました。

商品につきましては、売上高は450百万円（前期比45.2%減）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高28,177百万円（前期比17.4%減）、うち製品売上高27,726百万円（前期比16.7%減）となりました。その結果、利益面では、営業利益1,496百万円（前期比3.3%減）、経常利益1,699百万円（前期比3.3%増）、当期純利益1,161百万円（前期比93.5%増）となりました。

Compounds for Semiconductor Wafers

Performance in the Group's mainstay business of compounds for semiconductor wafers reflected a second-quarter resurgence in wafer production volumes, although results were hampered by lackluster demand in the first quarter. Accordingly, sales of lapping materials fell 16.8% year on year, to ¥3,198 million, and sales of polishing compounds dropped 17.0%, to ¥7,839 million.

Polishing Compounds for CMP

Chemical mechanical planarization (CMP) products, which are needed to meet demand for highly dense wiring technologies using smaller design rules and increasingly dense device populations on semiconductor substrates, benefited to a certain extent from the recovery in demand for semiconductor devices. Nevertheless, sales of these compounds decreased 12.1% during the year, to ¥7,262 million.

Compounds for Hard Disks

Higher demand for notebook personal computers boosted demand for compounds for hard disks, and demand for compounds for glass substrates grew robust in the second quarter. Hampered by sluggish demand in the first quarter, however, sales of compounds for hard disks fell 25.9% during the year, to ¥2,570 million.

For Wire Saws, Thermal Sprays, LCD Devices and Other Products

Abrasives for wire saws, which are used to slice silicon, suffered mainly in line with sluggish European markets for photovoltaic cells, and sales of these compounds decreased 24.7%, to ¥1,897 million.

In thermal spray materials, we strove to expand sales of our mainstay cermet materials. However, affected by the lackluster state of the steel and semiconductor industries, sales dropped 10.1%, to ¥876 million.

Lower market prices affected sales of our abrasives for quartz oscillators and other quartz devices, but owing to strong demand for their use in mobile phone products, sales in this category rose 13.4% year on year, to ¥615 million.

Sales of merchandise amounted to ¥450 million, down 45.2%.

Owing to the factors mentioned above, net sales declined 17.4%, to ¥28,177 million. Of this total, product sales amounted to ¥27,726 million, down 16.7%. Operating income fell 3.3%, to ¥1,496 million, while ordinary income increased 3.3%, to ¥1,699 million. Net income surged 93.5%, to ¥1,161 million.

収益性
Profitability

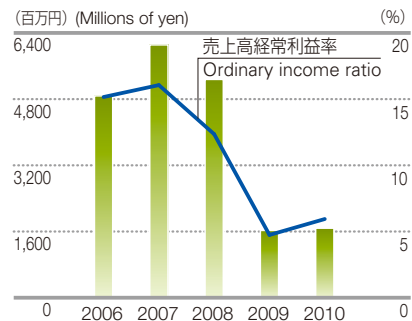
営業利益/売上高営業利益率

Operating Income and Operating Income Ratio



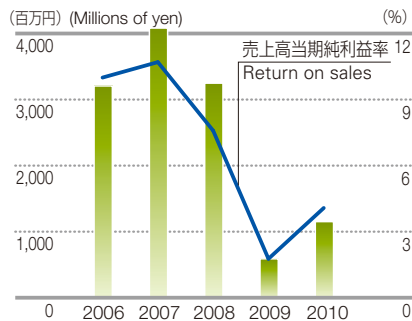
経常利益/売上高経常利益率

Ordinary Income and Ordinary Income Ratio



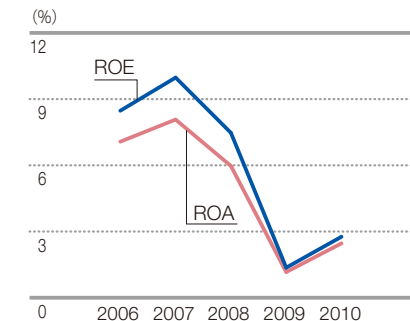
当期純利益/売上高当期純利益率

Net Income and Return on Sales



自己資本当期純利益率/総資産利益率

Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



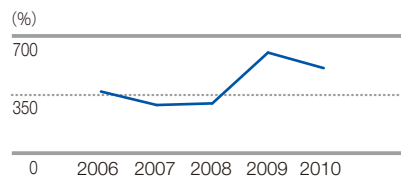
Fiscal years ended March 31

				平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
売上高	(百万円)	Net sales	(millions of yen)	32,127	38,060	42,630	34,122	28,177
営業利益	(百万円)	Operating income	(millions of yen)	4,772	5,979	5,226	1,547	1,496
売上高営業利益率	(%)	Operating income ratio	(%)	14.9	15.7	12.3	4.5	5.3
経常利益	(百万円)	Ordinary income	(millions of yen)	4,892	6,122	5,289	1,645	1,699
売上高経常利益率	(%)	Ordinary income ratio	(%)	15.2	16.1	12.4	4.8	6.0
当期純利益	(百万円)	Net income	(millions of yen)	3,207	4,080	3,249	600	1,161
売上高当期純利益率	(%)	Return on sales	(%)	10.0	10.7	7.6	1.8	4.1
自己資本当期純利益率〔ROE〕	(%)	Return on equity	(%)	8.5	10.0	7.5	1.4	2.8
総資産利益率〔ROA〕	(%)	Return on assets	(%)	7.1	8.1	6.0	1.2	2.5

安定性 Stability

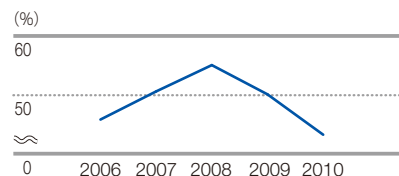
流動比率

Current Ratio



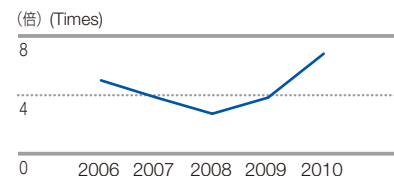
固定比率

Fixed Assets Ratio



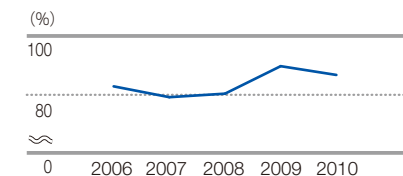
手元流動性比率

Current (Quick) Ratio



自己資本比率

Equity Ratio



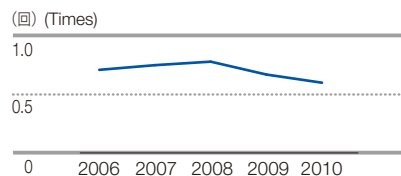
Fiscal years ended March 31

				平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
流動比率	(%)	Current ratio	(%)	373.7	293.0	302.8	606.6	513.8
固定比率	(%)	Fixed assets ratio	(%)	45.9	50.7	55.2	50.2	43.3
手元流動性比率	(倍)	Current (quick) ratio	(times)	5.1	3.9	2.8	3.9	6.9
自己資本比率	(%)	Equity ratio	(%)	82.8	79.1	80.3	89.7	86.7

生産性/ 効率性 Productivity and Efficiency

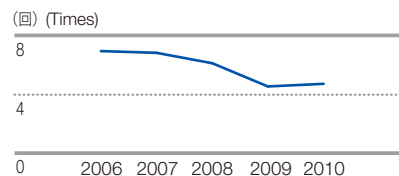
総資産回転率

Assets Turnover



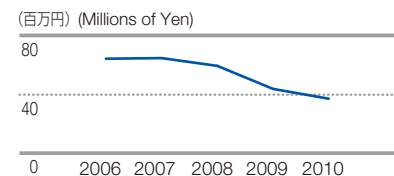
たな卸資産回転率

Inventories Turnover



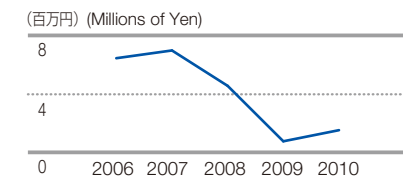
従業員1人当たり売上高

Net Sales per Employee



従業員1人当たり当期純利益

Net Income per Employee

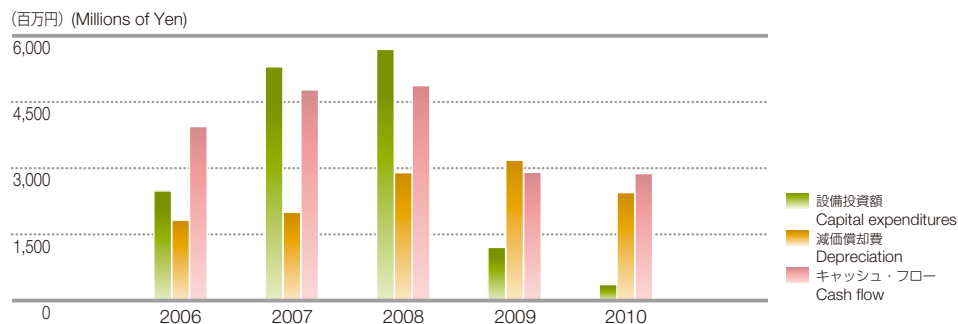


Fiscal years ended March 31

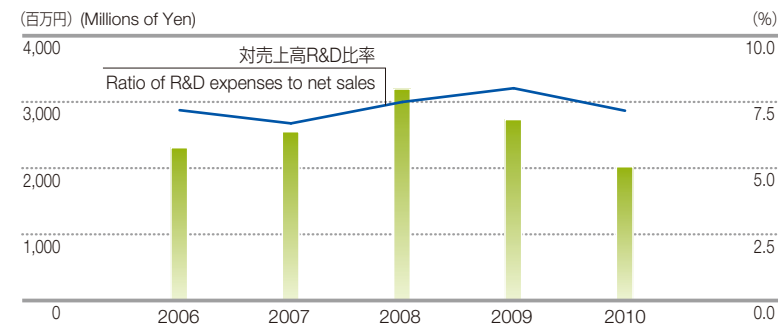
				平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
総資産回転率	(回)	Assets turnover	(times)	0.71	0.75	0.78	0.67	0.60
たな卸資産回転率	(回)	Inventories turnover	(times)	6.97	6.85	6.14	4.55	4.73
従業員1人当たり売上高	(百万円)	Net sales per employee	(millions of yen)	64.64	65.06	59.79	44.00	37.29
従業員1人当たり当期純利益	(百万円)	Net income per employee	(millions of yen)	6.45	6.98	4.56	0.77	1.53
従業員数	(人)	Number of employees		520	650	776	775	736

設備投資
研究開発
Capital
Expenditures
and
Research and
Development

設備投資額/減価償却費/キャッシュ・フロー
Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/対売上高R&D比率
R&D Expenses and Ratio of R&D Expenses to Net Sales



Fiscal years ended March 31

				平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
設備投資額	(百万円)	Capital expenditures	(millions of yen)	2,486	5,299	5,694	1,207	363
減価償却費	(百万円)	Depreciation	(millions of yen)	1,824	2,004	2,899	3,183	2,448
キャッシュ・フロー ※1	(百万円)	Cash flow	(millions of yen)	3,945	4,778	4,873	2,909	2,880
研究開発費	(百万円)	R&D expenses	(millions of yen)	2,312	2,554	3,201	2,738	2,025
対売上高 R&D 比率	(%)	Ratio of R&D expenses to net sales	(%)	7.20	6.71	7.51	8.03	7.19

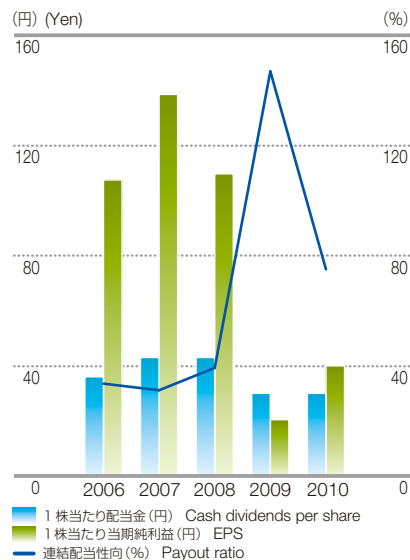
※1 キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 配当金

Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends

投資指標
Per Share
Data and
Others

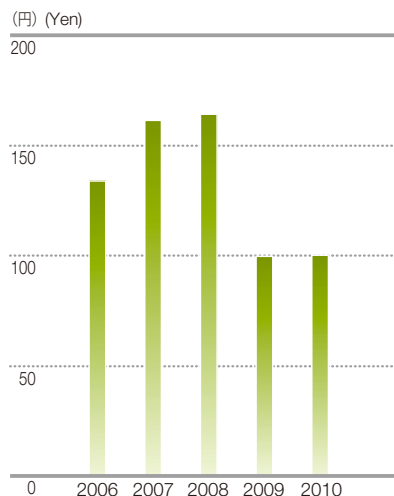
1株当たり配当金/連結配当性向/
1株当たり当期純利益 (EPS)

Cash Dividends per Share,
Payout Ratio, Earnings per Share (EPS)



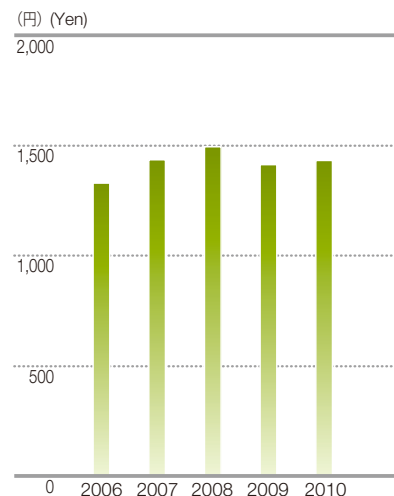
1株当たりキャッシュ・フロー

Cash Flow per Share



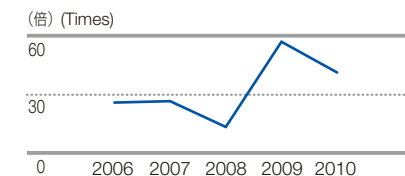
1株当たり純資産 (BPS)

Book-value per Share (BPS)



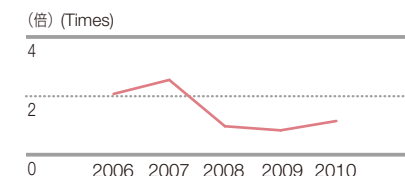
株価収益率 (PER)

Price Earnings Ratio (PER)



株価純資産倍率 (PBR)

Price Book-Value Ratio (PBR)



Fiscal years ended March 31

			平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
1株当たり配当金	(円) Cash dividends per share	(yen)	36.00	43.00	43.00	30.00	30.00
連結配当性向	(%) Payout ratio	(%)	33.5	31.1	39.2	146.8	75.0
1株当たり当期純利益 (EPS)	(円) Earnings per share	(yen)	107.42	138.45	109.64	20.44	39.98
1株当たりキャッシュ・フロー	(円) Cash flow per share	(yen)	133.93	161.46	164.26	99.72	100.23
1株当たり純資産 (BPS)	(円) Book-value per share	(yen)	1,329.68	1,435.75	1,494.76	1,413.55	1,432.59
株価収益率 (PER)	(倍) Price earning ratio	(times)	25.79	26.51	13.23	57.09	41.27
株価純資産倍率 (PBR)	(倍) Price book-value ratio	(times)	2.08	2.56	0.97	0.83	1.15

(百万円) (Millions of yen)

Fiscal years ended March 31

		平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
経常損益の部	Ordinary income and expenses					
営業損益の部	Operating income and expenses					
売上高	Net sales	32,127	38,060	42,630	34,122	28,177
売上原価	Cost of sales	21,415	24,974	29,429	25,178	20,573
売上総利益	Gross profit	10,712	13,086	13,201	8,943	7,604
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,939	7,106	7,975	7,396	6,107
営業利益	Operating income	4,772	5,979	5,226	1,547	1,496
営業外損益の部	Non-operating income and expenses					
受取利息	Interest income	39	79	102	90	50
受取配当金	Dividend income	20	3	4	4	—
その他の営業外収益	Other nonoperating income	101	101	74	87	174
営業外収益	Non-operating income	160	184	181	183	225
支払利息	Interest expenses	27	10	49	47	16
その他の営業外費用	Other nonoperating expenses	12	30	68	37	6
営業外費用	Non-operating expenses	40	41	118	85	22
経常利益	Ordinary income	4,892	6,122	5,289	1,645	1,699
特別損益の部	Extraordinary items					
固定資産売却益	Proceeds from sales of fixed assets	—	446	1	3	1
補助金収入	Subsidy income	49	23	33	36	—
その他の特別利益	Other extraordinary income	2	34	61	18	219
特別利益	Extraordinary income	51	504	96	58	220
固定資産除売却損	Loss on disposal of fixed assets	103	31	49	54	45
投資有価証券評価損	Loss on revaluation of investment securities	—	—	0	30	—
海外子会社過年度販売税延滞金	Overdue sales taxes of overseas subsidiaries	—	12	—	—	—
減損損失	Impairment loss	—	—	284	90	403
その他の特別損失	Other extraordinary losses	—	10	54	136	3
特別損失	Extraordinary losses	103	55	388	312	452
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	4,840	6,572	4,997	1,392	1,467
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	1,577	2,518	1,934	304	546
法人税等調整額	Income taxes-deferred	16	(30)	(224)	448	(255)
少数株主利益	Minority interest in earnings of consolidated subsidiaries	39	3	37	38	14
当期純利益	Net income	3,207	4,080	3,249	600	1,161

■ 連結貸借対照表 *Consolidated Balance Sheets*

(百万円) (Millions of yen)

As of March 31		平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
資産の部	Assets					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and cash equivalents	12,058	10,710	6,307	10,095	13,835
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	10,054	12,781	12,195	5,912	8,027
有価証券	Marketable securities	1,537	1,575	3,221	103	2,303
たな卸資産	Inventories	4,952	6,151	7,742	7,244	4,676
繰延税金資産	Deferred tax assets	615	688	640	236	751
短期貸付金	Short-term loans receivable	1	15	303	802	—
その他の流動資産	Other current assets	149	321	351	1,062	133
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(28)	(42)	(12)	(197)	(110)
流動資産合計	Total current assets	29,341	32,202	30,747	25,260	29,617
固定資産	Fixed assets					
有形固定資産	Tangible fixed assets					
建物及び構築物	Buildings and structures	6,444	7,931	9,018	8,297	7,568
機械装置及び運搬具	Machinery and equipment	2,938	3,868	5,147	4,496	3,181
土地	Land	3,430	3,439	3,448	3,428	3,400
その他の有形固定資産	Other tangible fixed assets	2,009	2,992	2,842	1,462	1,088
有形固定資産合計	Total tangible fixed assets	14,822	18,230	20,456	17,685	15,239
無形固定資産	Intangible fixed assets	295	324	425	363	331
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment in securities	905	530	314	184	253
長期貸付金	Long-term loans receivable	1	2	2	1	—
繰延税金資産	Deferred tax assets	43	24	384	360	82
その他の投資その他の資産	Other investments and assets	1,938	2,423	2,910	2,121	1,954
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(8)	(8)	(8)	(8)	(16)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	2,880	2,972	3,604	2,659	2,273
固定資産合計	Total fixed assets	17,998	21,528	24,485	20,708	17,844
資産合計	Total assets	47,340	53,730	55,233	45,969	47,462

(百万円) (Millions of yen)

		平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
負債の部	Liabilities					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable	4,276	5,373	5,185	2,414	3,335
短期借入金	Short-term borrowings	354	340	720	145	184
未払法人税等	Corporate tax payable	859	1,251	793	76	476
賞与引当金	Allowance for bonuses payable	523	531	570	368	456
その他の流動負債	Other current liabilities	1,837	3,493	2,884	1,159	1,310
流動負債合計	Total current liabilities	7,852	10,990	10,154	4,164	5,763
固定負債	Fixed liabilities					
長期借入金	Long-term borrowings	—	2	429	250	161
退職給付引当金	Allowance for employees' retirement benefits	78	89	89	85	98
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	—	10	13	7	5
長期未払金	Long-term accounts payable	108	—	—	—	—
その他	Other fixed liabilities	—	—	10	9	5
固定負債合計	Total fixed liabilities	187	102	543	352	271
負債合計	Total liabilities	8,039	11,092	10,697	4,517	6,035
資本の部	Shareholders' equity					
資本金	Common stock	4,753	—	—	—	—
資本剰余金	Retained earnings for capital surplus	5,045	—	—	—	—
利益剰余金	Retained earnings	30,457	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	Gain or loss on revaluation of other securities	230	—	—	—	—
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	361	—	—	—	—
自己株式	Treasury stock	(1,630)	—	—	—	—
資本合計	Total shareholders' equity	39,217	—	—	—	—
負債及び少数株主持分及び資本合計		47,340	—	—	—	—
純資産の部	Net assets					
資本金	Common stock	—	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	—	5,062	5,070	5,070	5,069
利益剰余金	Retained earnings	—	33,368	35,344	34,679	35,111
自己株式	Treasury stock	—	(1,445)	(1,349)	(2,104)	(2,764)
株主資本合計	Total shareholders' equity	—	41,738	43,818	42,398	42,170
評価・換算差額等	Valuation and transaction adjustments	—	757	522	(1,162)	(998)
新株予約権	Subscription rights to shares	—	—	11	44	63
少数株主持分	Minority interests	—	143	183	172	191
純資産合計	Total net assets	—	42,638	44,536	41,451	41,426
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	—	53,730	55,233	45,969	47,462

■ 連結キャッシュ・フロー計算書 *Consolidated Statements of Cash Flows*

(百万円) (Millions of yen)

Fiscal years ended March 31

		平成18年3月期 2006	平成19年3月期 2007	平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities					
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	4,840	6,572	4,997	1,392	1,467
減価償却費	Depreciation and amortization	1,824	2,013	2,899	3,183	2,448
減損損失	Impairment loss	—	—	284	90	403
固定資産除売却損益 (益)	Loss (gain) on sale or disposal of fixed assets	—	(446)	47	50	43
売上債権増減額 (増加)	(Increase) decrease in receivables	(2,061)	(2,602)	538	5,777	(2,081)
仕入債務増減額 (減少)	Increase (decrease) in payables	489	930	(149)	(2,140)	856
たな卸資産増減額 (増加)	(Increase) decrease in inventories	(248)	(1,327)	(1,676)	(359)	2,656
その他	Others	123	(70)	(84)	(250)	149
小計	Subtotal	4,968	5,070	6,856	7,743	5,944
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends received	59	77	104	89	51
補助金の受取額	Income from new industry subsidies	—	49	23	33	99
事業撤退に伴う収入	Income from withdrawal from business	—	—	—	—	32
事業撤退による支出	Payments for withdrawal from business	—	—	—	(17)	—
利息の支払額	Interest paid	(27)	(10)	(45)	(48)	(16)
法人税等の支払額	Income taxes paid	(1,748)	(2,196)	(2,325)	(1,814)	(135)
法人税等の還付額	Income taxes refunded	—	—	—	—	791
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents provided by operating activities	3,251	2,990	4,613	5,986	6,768
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities					
定期預金の預入による支出	Payments for additions to fixed deposits	—	(1,000)	(500)	—	(1,500)
定期預金の払戻による収入	Income from withdrawal of fixed deposits	—	—	500	800	150
有価証券の増減額 (減少)	(Increase) decrease in marketable securities	(1,000)	1,000	(99)	—	99
有形固定資産取得による支出	Purchase of tangible fixed assets	(1,923)	(3,758)	(6,046)	(2,382)	(256)
子会社株式取得による支出	Purchase of shares in subsidiaries and affiliates	(345)	—	—	—	—
その他	Others	456	576	(225)	8	(87)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in investing activities	(2,811)	(3,182)	(6,371)	(1,573)	(1,594)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities					
短期借入金の純増減額 (減少)	Increase (decrease) in short-term borrowings	(309)	(17)	288	(487)	37
長期借入による収入	Proceeds from long-term loans payable	—	—	559	—	—
長期借入金の返済による支出	Expenses from repayment of long-term borrowings	—	(1)	(1)	(106)	(93)
自己株式の取得及び売却による収支	Proceeds from sales of (payments for purchase of) treasury stock	126	201	104	(755)	(675)
親会社による配当金の支払額	Payment of dividends by the parent company	(822)	(1,119)	(1,273)	(1,265)	(729)
その他	Others	—	—	—	(4)	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in financing activities	(1,005)	(936)	(321)	(2,618)	(1,450)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and equivalents	192	113	23	(624)	17
現金及び現金同等物の増加 (減少) 額	Increase (decrease) in cash and cash equivalents	(373)	(1,015)	(2,055)	1,169	3,740
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of year	12,969	12,595	11,785	9,729	10,899
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of year	12,595	11,785	9,729	10,899	14,639

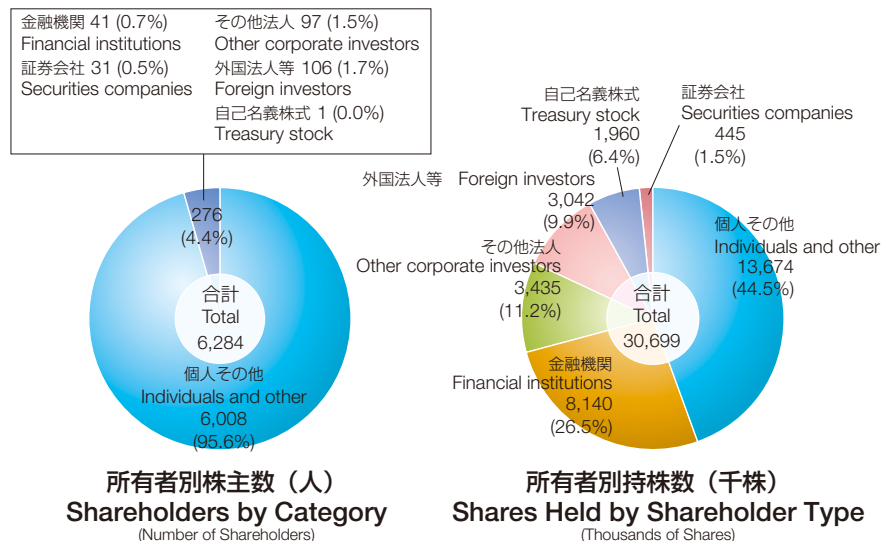
大株主一覧 2010年(平成22年)3月31日現在 Leading Shareholders (as of March 31, 2010)

株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Percentage of Total
越山 勇	Isamu Koshiyama	2,902	9.5
野田 純孝	Sumitaka Noda	2,320	7.6
株式会社フジミンコーポレーテッド (自己株口)	Fujimi Incorporated (Treasury Stock)	1,960	6.4
有限会社コマ	Koma Co., Ltd.	1,638	5.3
日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	1,425	4.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社(信託口)	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	1,298	4.2
越山 彰	Akira Koshiyama	1,151	3.8
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	779	2.5
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.4
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.3

(注) 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を四捨五入しています。
Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is rounded to the nearest one-tenth of one percent.

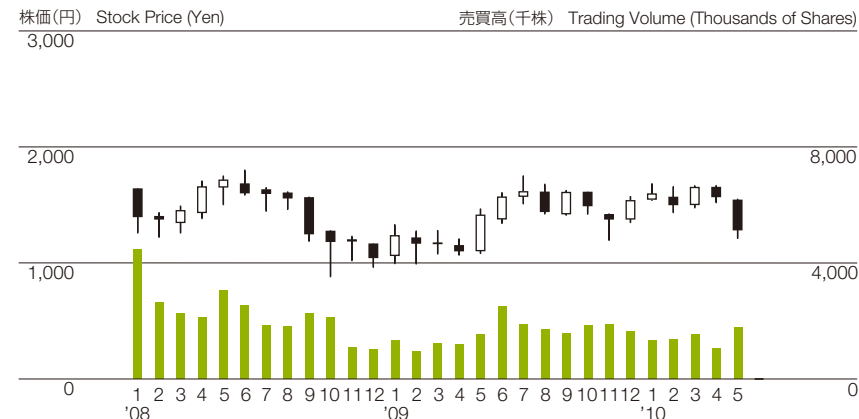
所有者別分布状況 2010年(平成22年)3月31日現在

Composition of Shareholders by Category (as of March 31, 2010)



株価および出来高の推移

Stock Price and Trading Volume



発行済株式の推移 Common Stock Issues

摘 要 Type of Issue				発行済株式数 (千株) Shares Outstanding after Issue (Thousands of Shares)
1992年(平成4年)2月1日	February 1, 1992	第三者割当増資	Allotment of new shares to third parties	245
1992年(平成4年)11月20日	November 20, 1992	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split	491
1993年(平成5年)9月27日	September 27, 1993	新株引受権の権利行使	Exercise of warrants	509
1994年(平成6年)5月20日	May 20, 1994	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split	1,019
1994年(平成6年)8月4日	August 4, 1994	500円額面株式1株を50円額面株式10株に分割	Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	10,195
1995年(平成7年)4月18日	April 18, 1995	一般公募増資	Public offering of common stock	10,995
1996年(平成8年)5月20日	May 20, 1996	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split	12,094
1996年(平成8年)10月1日	October 1, 1996	一般公募増資	Public offering of common stock	12,894
1997年(平成9年)5月20日	May 20, 1997	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split	14,184
1998年(平成10年)5月20日	May 20, 1998	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split	15,602
2001年(平成13年)11月22日	November 22, 2001	自己株式の利益消却	Treasury stock purchased and retired	15,349
2005年(平成17年)5月20日	May 20, 2005	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split	30,699

商号 Name	株式会社フジインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年(昭和28年)3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 証券コード 5384 Tokyo Stock Exchange (First Section) Code 5384 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section)
従業員数 Number of employees	736 (個別 Non-Consolidated 576)

役員 2010年(平成22年)6月23日現在

Board of Directors (As of June 23, 2010)

代表取締役社長	関 敬史	President	Keishi Seki
取締役	児玉 一志	Director	Hitoshi Kodama
取締役	松島 伸男	Director	Nobuo Matsushima
取締役	土屋太加志	Director	Takashi Tsuchiya
取締役	伊藤 広一	Director	Hirokazu Ito
常勤監査役	藤本 俊之	Standing Corporate Auditor	Toshiyuki Fujimoto
常勤監査役	石井 和廣	Standing Corporate Auditor	Kazuhiro Ishii
監査役	鮎澤 多俊	Corporate Auditor	Tashun Aizawa
監査役	山下 紀雄	Corporate Auditor	Norio Yamashita

事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場
Headquarters・Biwajima Plant
〒452-8502
愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi,
452-8502, Japan
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場
Inazawa Plant
〒492-8329
愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi,
492-8329, Japan

各務原工場
Kakamigahara Plant
〒504-0927
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu,
504-0927, Japan

各務東町工場
Kakamihigashimachi Plant
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu,
509-0103, Japan

溶射材事業部
Thermal Spray Materials Department
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu,
509-0103, Japan

研究開発センター
R&D Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8
8, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu,
509-0109, Japan

物流センター
Logistics Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1
1, Technoplaza-4, Kakamigahara, Gifu,
509-0109, Japan

東京営業所
Tokyo Office
〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-2-8 COI 内神田ビル 7F
7th Floor, COI Uchikanda Bldg., 2-8,
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
101-0047, Japan

台湾事務所
Taiwan Office
新竹縣 302 竹北市縣政九路 215 號 4 樓
4th Floor, No. 215, Shian-Jheng 9th Rd.,
Jubei City, Hsinchu Hsien 302 Taiwan, ROC

上海事務所
Shanghai Office
上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室
317B, German Center, 88 Keyuan Road,
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

韓国事務所
Korea Office
RM. 3032, 30th floor, ASEM Tower, 159-1, Samsung-Dong,
Gangnam-Gu, Seoul

関連会社 Affiliated Companies

FUJIMI CORPORATION
11200 SW Leveton Drive, Tualatin,
Oregon 97062, U.S.A.
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
Unit 3, Level 15, Menara Genesis No. 33,
Jalan Sultan Ismail 50250, Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +60-3-2143-0036 Fax: +60-3-2145-8955

FUJIMI EUROPE LIMITED
The Granary, Wolvey Lodge Business Centre,
Cloudesley Bush Lane, Wolvey, Hinckley, Leicestershire,
LE10 3HB, England
Phone: +44-1455-222090 Fax: +44-1455-222099

FUJIMI EUROPE GMBH
Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany
Phone: +49-7940-58402 Fax: +49-7940-57611